

无锡芯朋微电子股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“芯朋微”）于 2024 年 4 月 12 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，于 2024 年 8 月 16 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。

2025 年，以培育新质生产力为核心目标，公司结合自身发展战略和经营情况，制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案主要举措如下：

一、聚焦主营业务，提升产品核心竞争力

公司成立 20 年来始终专注于功率集成电路的研发、销售，以自主创新为经营核心宗旨，为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的功率集成电路产品，推动整机的能效提升和技术升级。公司主要产品覆盖了功率芯片的大部分技术种类，产品应用市场覆盖了家用电器、标准电源以及工业设备等重点领域。

2024 年，公司本着以研发创新为发展基石，持续地、有计划地推进公司自主研发，2024 年度公司研发费用为 22,612.61 万元，占公司营业收入的 23.44%。公司基于自主研发迭代的“高低压集成技术平台”和“数字功率控制技术平台”，已推出 8/12/20 相数字电源控制器、50~70A 智能 DrMOS、600V IGBT、600V/800V Smart SuperJunction MOSFET、车规级 1200V SiCMOSFET、1200V HB 驱动芯片、车规级 1700V 电源芯片、车规级 5000V 隔离数字单路/多路驱动芯片、800V~1500V 系列工业辅源芯片、工业级 5VDC-DC 全集成 SiP 电源模块及 600V IPM 模块。

2025 年，公司将继续沿着“消费级-工业级-车规级”纵向应用需求路线开发

系列产品，丰富拓宽“数字/模拟、高压/低压、隔离/非隔离”全功率技术平台，向客户整机系统提供从高低压电源、高低压驱动及其配套器件/模块的功率全套解决方案，实现同一台整机中 AC-DC、DC-DC、Gate Driver（HV&LV）、IGBT、SuperJunction MOSFET、SiC MOSFET、SiP、IPM 等多品类“Chipown Inside”，缩短了客户开发周期，显著提升公司各产品线的协同竞争效应，提高销售效率。

二、持续完善投资者回报机制

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者回报，将利润分配政策写入公司章程，在兼顾自身实际经营情况和未来可持续发展的基础上，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制。自 2020 年在上海证券交易所科创板上市以来，公司积极实施现金分红并开展回购，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。

（一）截至 2024 年 12 月 31 日，公司共计现金分红 14,872.24 万元；公司实施 3 次股份回购，回购金额为 19,834.09 万元。分红回购金额合计 34,706.33 万元，占 2024 年归属于上市公司股东净利润总额的 311.74%。

（二）2024 年度利润分配预案，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟每 10 股派发现金红利 4 元，合计拟派发现金红利约 5,097.51 万元（含税）。公司 2024 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

三、持续加强募投项目管理，提升科技创新能力

2022 年 3 月，公司披露了定增预案，募集资金将用于“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”、“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”和苏州研发中心的建设、实施。

2024 年，面向数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等大功率工业场景，公司持续衍生数字电源芯片、高压智能驱动芯片、隔离驱动芯片、智能 DrMOS、IGBT、SuperJunction MOSFET、SiC MOSFET 等器件系列以及工业级电源模块系列产品，以满足客户多样需求。2024 年公司高/低压驱动芯片、数字电源芯片、智能功率器件及模块营收同比增长 60%以上。

2025 年，公司将继续推进“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”、“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”和苏

州研发中心的建设、实施；同时，持续加强募集资金管理规定，审慎使用募集资金，以募投项目的落地促进公司主营业务，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

四、完善公司治理结构

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构。

2024 年，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合增加注册资本的基本情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行了修订。公司董监高积极参与了“独立董事制度改革专题培训”、“独立董事后续培训”、“董监高初任培训”、“董事会秘书后续培训”等上交所等监管机构举办的培训，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

2025 年，公司将紧密关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。

五、强化管理层与股东的利益共担共享约束及强化“关键少数”的责任

公司自 2020 年在上海证券交易所科创板上市至今，先后实施了 4 次限制性股票激励计划、1 次员工持股计划的股权激励措施，公司对激励计划设定了公司层面营业收入/营业收入增长率的业绩考核要求，同严密的个人层面绩效考核结合，能有效地将股东利益、公司利益和管理层及公司核心骨干的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司发展质量，增强投资者回报。

2024 年，公司发布 2024 年限制性股票激励计划草案，该激励计划设定了公司层面营业收入/营业收入增长率的业绩考核要求，同严密的个人层面绩效考核结合，能有效地将股东利益、公司利益和管理层及公司核心骨干的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司发展质量，增强投资者回报。

2025 年，公司将延续 2024 年度的 KPI 考核方式，除短期财务目标外，提升非财务、长期目标及持续学习项目的权重，高管薪酬与 KPI 考核强关联，KPI 考核与公司长远发展和股东利益相结合，有利于保障公司的长期稳定发展，增强投

投资者信心。同时，董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。

六、提升信披质量，加强与投资者的沟通

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 E 互动、分析师会议及业绩说明会等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。2024 年，公司举办了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，答复上证 E 互动问题 86 条，通过线上线下等方式，累计接待 330 余人次家券商、机构及个人的调研沟通或电话沟通。通过多种形式，加强与广大投资者的沟通，提高公司在资本市场的开放性，让投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况、发展现状等，增强投资者对公司的信心，努力夯实资本市场高质量发展基础。

2025 年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，增加投资者沟通交流活动。在每个财务季度结束后，举办业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，提高业绩信息的透明度和可理解性；定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解；进行线上路演，利用互联网平台进行公开的业绩说明和互动交流，为更多投资者提供参与的机会，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2025 年公司将计划安排一系列投资者关系活动，包括不少于 3 次业绩说明会或投资者接待日，不少于 20 次的投资者调研活动等。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公

公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日